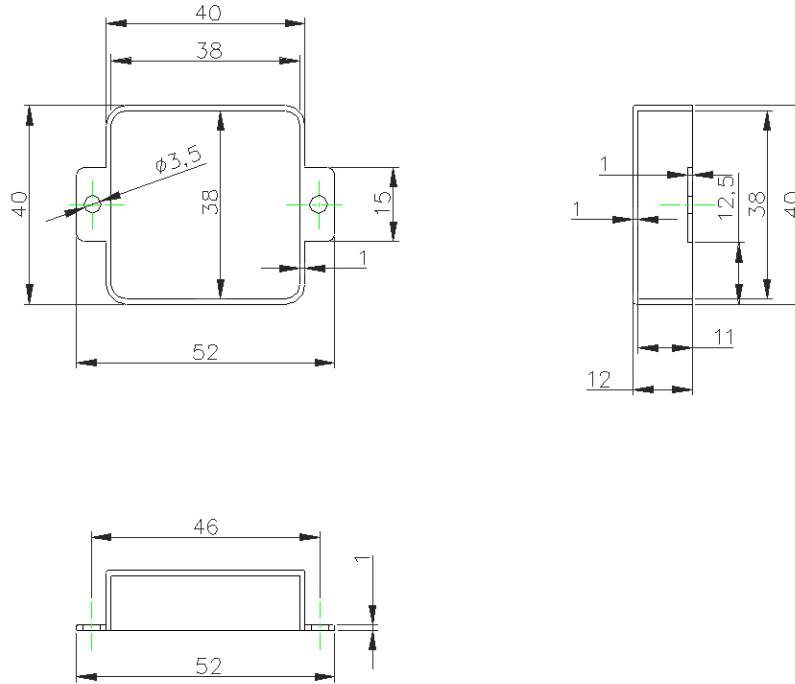


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.

Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen der Platine mit Gießharz verschlossen.

[Verwendungsbereich] G059 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen		[Zul. Abw.]	[Oberfl.]	Maßstab 1:1	[Gewicht]
				[Werkstoff, Halbzeug] [Rohteil-Nr] [Modell- oder Gesenk-Nr]	Thermoplast
			Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE
		Bearb	25.04.05	M.SIMON	
		Gepr.			
		Norm			
				G059	Blatt 1 von 1
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH	Ersatz für- Ersatz durch-